

附件一

公司简介

福建省福联集成电路有限公司为福建省电子信息（集团）有限公司投资控股的国有企业，专注于第二代与第三代半导体芯片制造的晶圆专工服务，成立于2015年10月，第一期投资10亿元人民币，在福建省莆田市建设一座砷化镓芯片制造的6英寸晶圆厂，于2017年正式投产；二期计划投资20亿元扩建砷化镓产能并建设一座氮化镓芯片制造的晶圆厂。本公司为“福建省政府2016与2017年的重点建设项目”，并已经列为“国家十三五集成电路重大生产力布局规划项目”。

公司以主流的工艺技术、先进的制造设备、具有成功经验的量产团队，凭借稳定的制造能力，提供客户最高价值的晶圆专工服务；以具有持续性的工艺开发能力、客户导向的服务内容，矢志成为客户长期合作的最佳伙伴。

公司拥有有顶尖的团队和坚强的股东，以成为全球化合物半导体晶圆专工服务的领先公司为愿景；以诚（诚信）、新（创新）、捷（快速）、融（群融）为企业文化；以与客户共同合作创造双赢为努力目标。

人才岗位需求信息表

填报单位(盖章): 福建省福联集成电路有限公司 单位性质: 国有企业 所属行业(领域): 新一代信息技术制造业

序号	岗位名称	需求人数	专业要求	条件要求(学历学位、专业技术职务、业绩能力等)	提供待遇(年薪、工作和生活条件等)	引进方式(全职、兼职、项目合作等)	引进国家(地区)	备注
1	研发工程师	8	微电子、电子工程、电机、物理、材料相关专业	硕士学位,了解半导体器件的工作原理,半导体工艺技术或整合等相关经验,熟悉高频量测,有射频相关背景和半导体器件建模等经验者	薪资面议,双休,供食宿娱乐健身中心等,享有法定带薪假期及年假,属引进国家地区的待遇更优	全职	台湾或在外省工作学习的福建籍理工人才	
2	制程工程师	6	化学/材料/电子/光电/理工相关	硕士学位,有光电半导体相关经验,从事黄光、薄膜、干,湿蚀刻、研磨,切割工艺作业				

[2017-05-18 11:02:39] [打印用户: 蔡婷婷]

联系地址: 福建省莆田市涵江区涵港西路368号 网址: <http://www.unicompound.com>

- 注: 1、单位性质可选择:国有企业、民营企业、外资企业、事业单位、社团组织、其他等。
 2、所属行业(领域)可选择:电子信息、机械制造、石油化工、轻工纺织、生物医药、新材料、节能环保、现代农业、海洋高新、文化创意、经营管理、人文社科、现代服务业、其他等。
 3、根据省政府部署要求,拟适时组织互联网、电子信息相关企业赴台湾开展人才项目对接活动,有意向的单位可在表中备注栏标注。